**Pressemitteilung**

Nr.: REN0803(A)

**Renesas Electronics beschleunigt die Entwicklung von Sensornetzwerk-Gateways mit seiner RZ/N1S IO-Link-Master-Lösung für intelligente Fabriken**

*One-Chip-Lösung und benutzerfreundliches Entwicklungskit vereinfachen IO-Link-basierte Anwendungen für die Industrie 4.0*

Düsseldorf, 23. November 2018 – Renesas Electronics Corporation (TSE: 6723), ein führender Anbieter hochmoderner Halbleiterlösungen, präsentiert ein neues IO-Link-Master-Entwicklungskit, um die Entwicklung von IO-Link-basierten Anwendungen für vernetzte Industriegeräte in intelligenten Fabriken zu beschleunigen.

Die RZ/N1S IO-Link-Master-Lösung verringert die Stücklistenkosten sowie den Platzbedarf. Unterstützung für die Lösung bieten zwei CPUs, die parallel und unabhängig voneinander mit einem großen integrierten SRAM arbeiten. Eine CPU steuert den IO-Link-Master mit acht Ports. Die andere CPU verfügt über eine R-IN-Engine-Architektur und unterstützt die Industrial-Ethernet-Kommunikation zu den oberen Schichten, wie beispielsweise einer SPS, ohne externen Mikrocontroller, Mikroprozessor oder DDR-Speicher. Dank der Integration der beiden CPUs in einem kleinen 12 mm x 12 mm LFBGA-Gehäuse lassen sich kompakte Leiterplatten entwickeln.

Zum Entwicklungskit gehören eine Leiterplatte und eine vorqualifizierte Beispielsoftware von TMG. Das Board verfügt über acht IO-Link-Steckverbinder mit denen Entwickler IO-Link-Slave-Bausteine sofort verbinden und mit dem Evaluierungsprozess starten können. Das benutzerfreundliche Entwicklungskit verkürzt die Prozesszeit von Prototypen bis zur Produktion und hilft damit, den Entwicklungsaufwand zu verringern.

**Die wichtigsten Features der RZ/N1S IO-Link-Master-Lösung**

Eine leistungsstarke Entwicklungsumgebung verkürzt den Zeitaufwand für die System-Evaluierung um bis zu sechs Monate.

* Das All-in-One-Entwicklungskit macht es den Anwendern leicht, sofort mit der Evaluierung zu beginnen und die Markteinführung zu beschleunigen.
* Das Board ermöglicht den schnellen Aufbau eines Prototypen mit IO-Link-Konnektivität für acht Ports und Anschlussmöglichkeiten an beliebige IO-Link-Slave-Geräte.
* Die vorqualifizierte Beispielsoftware des Partnerunternehmens [TMG TE](https://www.tmgte.de/en/) verkürzt die üblicherweise benötigte Zeit für den Übergang vom Prototypen zur Serienfertigung.

Optimiertes Design für begrenzte Platzverhältnisse und industrielle Umgebungen

* 6 MB On-Chip SRAM erübrigen den Bedarf an externem Speicher.
* Das kleine 12 mm x 12 mm LFBGA-Gehäuse macht die Master-Lösung zur idealen Wahl für Leiterplatten in Industrieanwendungen mit begrenztem Platz.

„Als führender Anbieter von IO-Link-Master-Lösungen unterstützt die TMG die IO-Link-Entwickler seit Einführung dieser Technologie. Kompakte Abmessungen, zwei integrierte CPUs – eine für IO-Link und die andere für die Industrial-Ethernet-Kommunikation – machen den RZ/N1S zur idealen Wahl für typische IO-Link-Master-Anwendungen. Wir freuen uns, unseren Stack für IO-Link, PROFINET und EtherNet/IP den RZ/N1S-Anwendern bereitstellen zu können“, erklärt Klaus-Peter Willems, Managing Partner von TMG.

„Seit mehr als 25 Jahren bietet Renesas eine Vielzahl von Lösungen für den Markt der Industrieautomatisierung und unterstützt seine Kunden bei der Einführung von Industrie 4.0“, erklärt Akira Denda, Vice President, Industrial Automation Business Unit, Renesas Electronics Corporation. „Diese neue IO-Link-Master-Lösung mit der Unterstützung des Protokoll-Stacks von TMG hilft Entwicklern dabei, innovative Anwendungen einfacher und schneller auf den Markt zu bringen sowie den Einsatz von IO-Link-basierten Anwendungen in intelligenten Fabriken weiter auszubauen.“

Renesas präsentiert seine neue IO-Link-Master-Lösung vom 27. bis zum 29. November 2018 auf der Fachmesse [SPS IPC Drives](https://www.mesago.de/de/SPS/home.htm?ovs_tnid=0) in Nürnberg auf seinem Messestand 130 in Halle 10.1.

Weitere Informationen über die RZ/N1S IO-Link-Lösung unter: <https://www.renesas.com/us/en/products/software-tools/boards-and-kits/eval-demo/io-link-master-development-kit.html>

Ergänzende Informationen über IO-Link sind verfügbar unter: <http://www.io-link.com/>

**Verfügbarkeit**

Die RZ/N1S IO-Link-Master-Lösung ist ab sofort erhältlich.

**Über Renesas Electronics Corporation**

Renesas Electronics Corporation liefert mit seinen umfassenden Halbleiterlösungen innovatives und zuverlässiges Embedded-Design. Als einer der [weltweit](https://www.renesas.com/about/company/profile/global.html) führenden Anbieter von Mikrocontrollern, A&P- und SoC-Produkten sowie integrierten Plattformen steht Renesas für langjährige Expertise und höchste Qualität. Mit seiner breiten Lösungspalette fokussiert Renesas auf die Anwendungsbereiche Automotive, Industrie, Smart Home, Büroautomation sowie Informations- und Kommunikationstechnologie. Weitere Informationen unter: [renesas.com](https://www.renesas.com)

###

**Hinweis**

Alle anderen in dieser Pressemitteilung erwähnten Namen von Produkten oder Dienstleistungen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer entsprechenden Inhaber.

**Unternehmenskontakt für Leser- und Kundenanfragen:**

Simone Kremser-Czoer

Renesas Electronics Europe GmbH, Karl-Hammerschmidt-Str. 42, 85609 Aschheim-Dornach   
Tel.: +49 89 38070-216  
E-Mail: [simone.kremser-czoer@renesas.com](mailto:simone.kremser-czoer@renesas.com)

Web: [www.renesas.com](http://www.renesas.com)

**Agenturkontakt für weitere Presseinformationen, Bildmaterial oder Artikelanfragen:**

Alexandra Janetzko

HBI Helga Bailey GmbH (PR-Agentur), Stefan-George-Ring 2, 81929 München

Tel.: +49 89 99 38 87-32

Fax: +49 89 930 24 45

E-Mail: [alexandra\_janetzko@hbi.de](mailto:alexandra_janetzko@hbi.de)

Web: [www.hbi.de](http://www.hbi.de/)